EPIGAP OSA

SPECIFICATIONS
SPEZIFIKATIONEN

EOPD-1300-1-0.3

SMD 1206

EOPD-1300-1-0.3

Features:

- Package 1206
- Package size: 3.2(L) x 1.6(W) x 1.2(H) mm
- Substrate: glass laminated epoxy
- Devices are ROHS and REACH compliant
- Lead free, gold plated soldering pads
- Taped in 8 mm blister tape, cathodes' position to transporting perforation
- Devices sorted into intensity classes, 1 class per reel
- Taping: face-up (T)

Merkmale:

- Bauform 1206
- Größe: 3,2 x 1,6 x 1,2 mm
- Trägerstreifen: Glasfaserlaminat
- Bauteile sind ROHS und REACH konform
- Bleifrei lötbar, Lötpads: vergoldet
- Gegurtet in 8 mm Blistergurt, Kathodenposition zur Transportperforation
- Alle Bauteile in Intensitätsklassen sortiert, 1 Klasse pro Spule
- Gurtung: Face-up (T)

• Typical Electro-Optical Characteristics
Typische Elektrooptische Eigenschaften

Measurement conditions
Messbedingungen: $T_{ambient}$ = 23 °C; $t_{test} \leq$ 60 ms

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Dark Current Dunkelstrom	I_D	U_R = 5 V		0.3	1	nA
Responsivity at 1300 nm Responsivität bei 1300 nm	$S_{\lambda=1300}$	U_R = 5 V	0.8	1.0		A/W
Responsivity at 1550 nm Responsivität bei 1550 nm	$S_{\lambda=1550}$	U_R = 5 V	0.9	1.1		A/W
Junction Capacitance Kapazität der Sperrschicht	C_J	U_R = 5 V		6	10	pF
Breakdown Voltage Druchbruchspannung	U_{BR}	I_R = 1 µA	25	35		V
Viewing Angle Abstrahlwinkel	φ			6		deg.

Copyright © 2024 EPIGAP OSA Photonics GmbH. All Rights Reserved

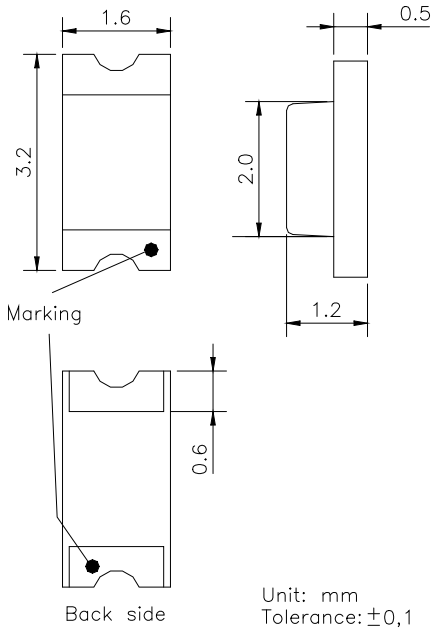
• Maximum Ratings
Grenzwerte

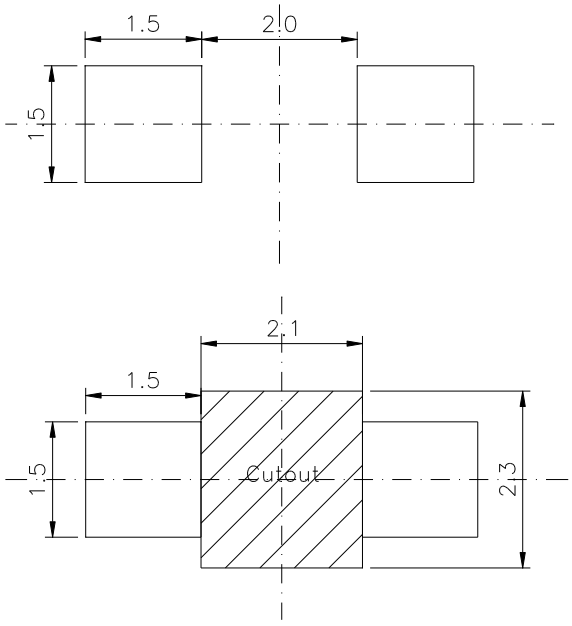
Parameter	Symbol	Min	Max	Unit
Operating Temperature Betriebstemperatur	T_{op}	-40	+85	°C
Storage Temperature Lagertemperatur	T_{St}	-40	+10	°C

Outline Drawing
Zeichnung

Soldering Pad
Lötpad

Unless otherwise specified, all drawing units are in mm
Tolerances are: ISO 2768-m

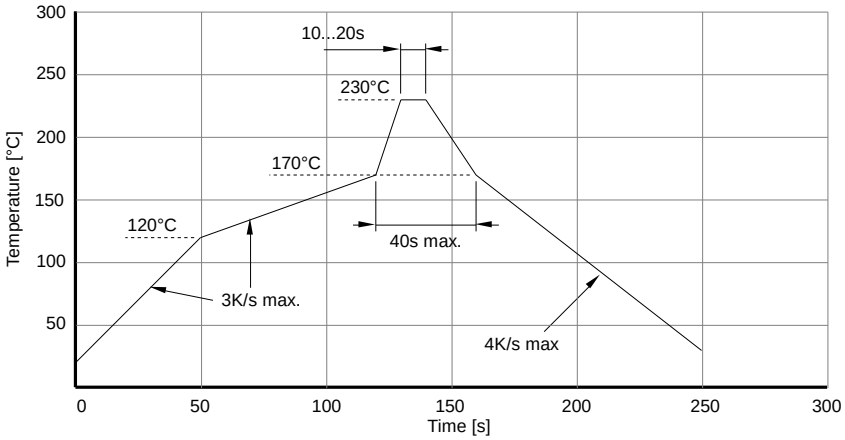




Marking at cathode
Markierung an der Kathode

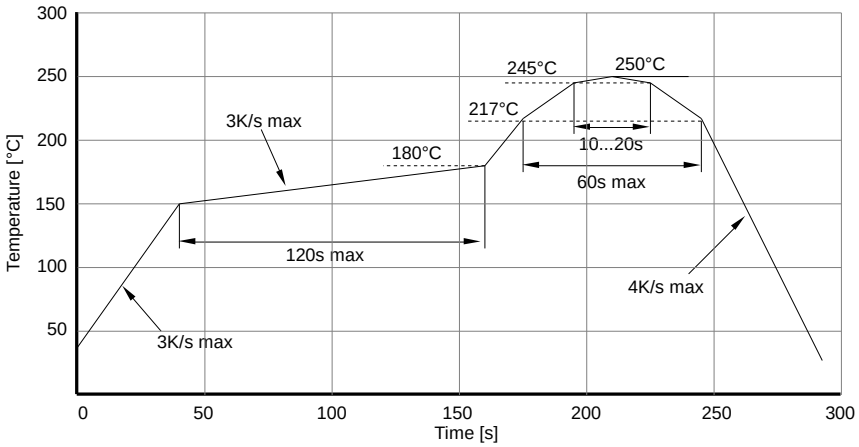
Copyright © 2024 EPIGAP OSA Photonics GmbH. All Rights Reserved

- **Soldering Profiles**
  Lötprofile



IR reflow soldering profile for solder containing Lead

IR Reflow Lötprozess für bleihaltiges Lot



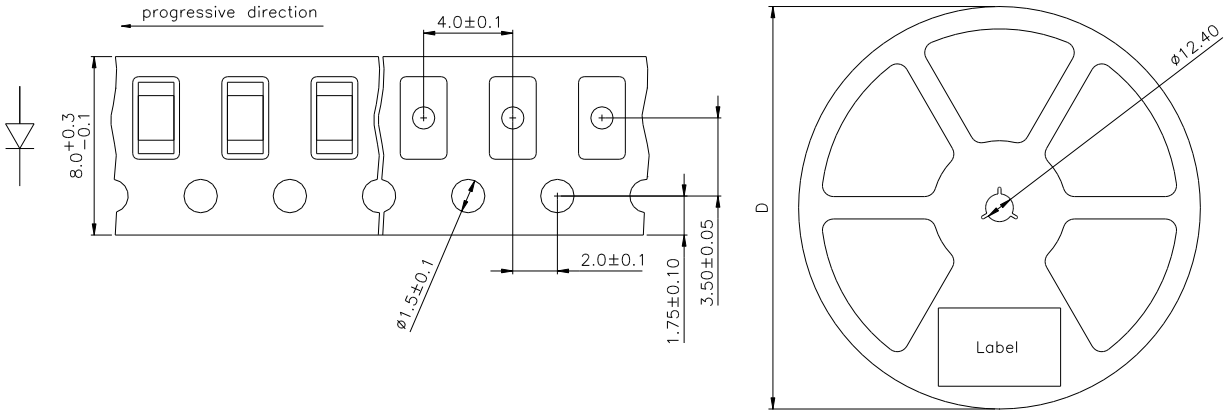
IR reflow soldering profile for Lead free soldering

IR Reflow Lötprozess für bleifreies Lot

Manual Soldering:	Max soldering iron power and time 25 W / 300 °C for 3 s
Manuelles Löten:	Max. Leistung des Lötkolben 25 W / 300 °C für 3 s

Copyright © 2024 EPIGAP OSA Photonics GmbH. All Rights Reserved

- **Tape And Reel Packaging**
  Gurt und Spule



D	Parts/reel
7''	3000

Packaging

The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica dry-pack.
Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30 °C and 60% Rh.
Floor life 12 month for Europe or 6 months for all other countries on max. 30 °C and 60% Rh in a dust free environment.
Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.

Verpackung

Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-Antistatic-Beutel verschweißt.
Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30 °C und 60% Rh.
Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen Länder bei max. 30 °C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.
Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.

Copyright © 2024 EPIGAP OSA Photonics GmbH. All Rights Reserved

Attention please

The information describes the type of component and shall not consider as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change reserved. The data sheet may change without prior notification; The only valid issue and current revision will be on our website. Due to technical requirements, components may contain dangerous substances.
Parameters can vary in different applications. The customer must validate all operating parameters for each customer application. EPIGAP OSA Photonics GmbH does not have the responsibility for the reliability and the degradation behavior of products made with EPIGAP OSA Photonics GmbH diodes because they depend not only on the diode but also on the conditions of manufacture or design of the final products. The customer is responsible to ensure the long-term stability of the product according to customer's requirements. If components are used in toys or, life support systems, then EPIGAP OSA Photonics GmbH must expressly authorize use of components prior to incorporation into the customer's systems!
Packaging: EPIGAP OSA Photonics GmbH uses recyclable packages; please use the recycling operators known to you.

Zur Beachtung

Dieses Datenblatt beschreibt typische, nicht uneingeschränkt garantierte Bauelementeigenschaften. Es gelten die AGB der EPIGAP OSA Photonics GmbH, das Recht zur Änderung dieser ist vorbehalten. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten, eine automatische Information erfolgt nicht. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Internet-Seite vorhanden. Auf Grund technischer Erfordernisse können die Bauelemente gefährliche Substanzen enthalten.
Produkteigenschaften können je nach Anwendung variieren. Die Produkteigenschaften müssen in der Anwendung durch den Kunden geprüft werden. EPIGAP OSA Photonics GmbH ist nicht für die Zuverlässigkeit und das Alterungsverhalten von Produkten, die unter Verwendung von der EPIGAP OSA Photonics GmbH hergestellten Dioden gefertigt wurden, verantwortlich, da Beides nicht nur von den Dioden selbst, sondern auch von Konstruktion und Fertigung des Endproduktes abhängt. Der Kunde ist verpflichtet, das Langzeitverhalten des Produktes gemäß seinen Anforderungen zu prüfen und freizugeben. Werden die Dioden in Spielzeug, lebenserhaltenden oder sicherheitsrelevanten Systemen und Geräten eingesetzt, muss dies durch die EPIGAP OSA Photonics GmbH ausdrücklich gestattet werden.
Rückgabe von Verpackungsmaterial: Die EPIGAP OSA Photonics GmbH verwendet wiederverwertbare Verpackung, bitte wenden Sie sich an einen örtlichen Verwerter.

EPIGAP OSA Photonics GmbH
www.epigap-osa.de

Köpenicker Str.325
12555 Berlin Germany
Tel. +49 (0)30 6576 3760
contact@epigap-osa.de

Copyright © 2024 EPIGAP OSA Photonics GmbH. All Rights Reserved